

Rahmenprogramm

Ergänzend zu den Vorträgen wird eine begleitende Ausstellung stattfinden. Wir bieten den Vortragenden die Möglichkeit Exponate zu ihren Themen zu zeigen. Außerdem stellt Hahn-Schickard ausgewählte Projekte und Themen vor, die zur Zusammenarbeit anregen sollen:

■ Ket4Clean Production

Individuelles Matchmaking für ihr Unternehmen mit Technologiezentren in ganz Europa



■ DigiPro

Digitale Prozesskette für individuell gefertigte Mikrosysteme



■ Mikrokomo

Wandlungsfähigkeit von Mikromontage-Anlagen



■ Mittelstand 4.0

Kompetenzzentrum *Textil vernetzt*
Wissenstransfer in die Industrie zum Thema Digitalisierung



■ Deutsche Institute für Textil- und Faserforschung Denkendorf

Sensorbasierte Textile Schaltungsträger



■ 3D-MID e. V.

Forschungsförderung für mechatronisch integrierte Produkte



■ Hahn-Schickard

Gedruckte Elektronik



■ Hahn-Schickard

Räumliche Elektronik

Informationen

Termin: Dienstag, 15. Oktober 2019

Registrierung: 8:15 Uhr

Beginn: 9:00 Uhr

Ort: Haus der Wirtschaft, Willi-Bleicher-Str. 19, 70174 Stuttgart

Anreise: www.hausderwirtschaft.de/anfahrt

Kontakt:

Bei Fragen zur Veranstaltung wenden Sie sich bitte an:

Claudia Feith

Telefon: +49 711 685-83732

E-Mail: Claudia.Feith@Hahn-Schickard.de

Anmeldung:

Bitte melden Sie sich bei Frau Carmen Bellezer an:

Telefon: +49 711 685-83712

E-Mail: MIDWorkshop.2019@Hahn-Schickard.de

Teilnahmegebühr:

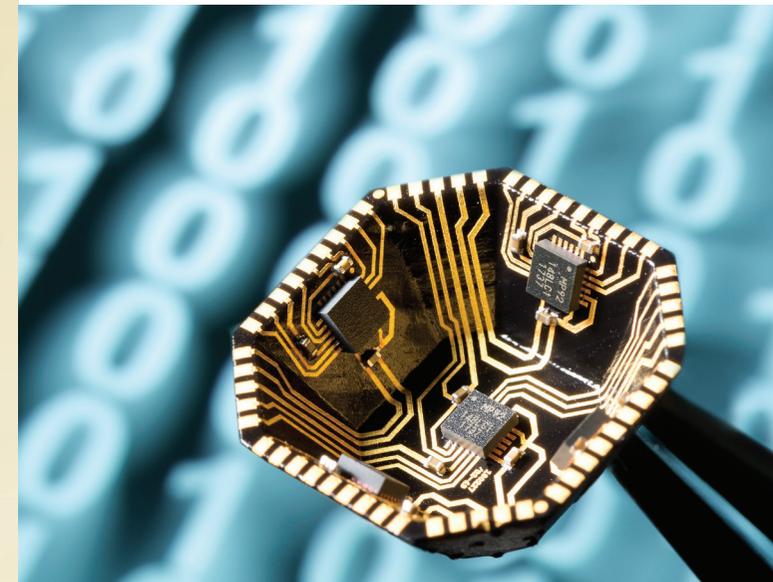
280,- EUR inkl. MwSt.

Die Teilnahmegebühr beinhaltet Verpflegung und Workshop-Unterlagen. Wir behalten uns vor, bei einem Rücktritt innerhalb 14 Tagen vor Veranstaltungsbeginn eine Pauschale von 20% und innerhalb 8 Tagen die volle Teilnahmegebühr zu berechnen. Bei Anmeldung von zwei oder mehr Teilnehmern bekommt ab dem zweiten Teilnehmer jeder weitere 10% Rabatt auf den Seminarpreis.

Datenschutz:

Im Rahmen der Veranstaltung werden Fotos gemacht und eine Teilnehmerliste erstellt. Wir verweisen auf unser Datenschutzbestimmungen unter www.Hahn-Schickard.de/Datenschutzerklaerung

Workshop Visions to Products - MID and Beyond



15. Oktober 2019
in Stuttgart

Workshop

Der Hahn-Schickard Workshop „Visions to Products – MID and Beyond“ bietet ein spannendes Programm mit internationalen Referenten aus Industrie und industrie-naher Forschung zu innovativen Anwendungen von Molded Interconnect Devices (MID).

Die diesjährige Veranstaltung schlägt eine Brücke zwischen räumlichen Schaltungsträgern und gedruckter Elektronik.

Einen wesentlichen Inhalt des Workshops bilden innovative Anwendungen der MID-Technologie. Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten werden durch applikationsorientierte Vorträge aus verschiedenen Industriezweigen beleuchtet. Dabei werden Anwendungen im Bereich der Hochfrequenztechnik in einer eigenen Session dargestellt.

Im Rahmen des Workshops möchten wir außerdem einen Ausblick auf Möglichkeiten der Zusammenarbeit rund um das Thema Räumliche Elektronik geben. Kommen Sie mit uns ins Gespräch.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Ihr
Prof. Dr.-Ing. André Zimmermann

Institutsleiter Hahn-Schickard
Institut für Mikraufbautechnik, Stuttgart



Programm

8:15 Registrierung

9:00 Eröffnung

Prof. Dr.-Ing. André Zimmermann

Grußwort

Claus Paal MdL

Wirtschaftspolitischer Sprecher der
CDU-Landtagsfraktion

9:15 Gedruckte Elektronik

Scalable 3D Printed Mechatronics

M. Hedges, Neotech AMT GmbH

Additive Production: Inkjetting Functional Materials in Industrial Applications

K. Keller, Notion Systems GmbH

Tampondruck und seine Freiheitsgrade

E. Warsitz, Franz Binder GmbH & Co.

10:30 Kaffeepause

11:00 HF-Technologie

All-sky Antennas for Radio Astronomy

D. Prinsloo, ASTRON

MID / LDS Technology Applications in Telecommunication Systems

S. Martens, Huawei Technologies GmbH

MID - an Enabling Technology for 5G

D. Manteuffel, Institute of Microwave and Wireless Systems, Leibniz University of Hannover

12:15 Mittagspause

Programm

13:30 Applikationen

LED Ring for Ophthalmic Applications

M. Manente, Next Sight Srl

MIDs from idea to production

E. Hirvonen, Harting AG

Development of a Miniature, Fully Integrated, Multipoint Pyrotechnic Initiation System Using LDS technology

M. Moguedet, S2P - Smart Plastic Products

Zuverlässigkeitsuntersuchungen und Lebensdauermodelle von LEDs auf räumlichen Schaltungsträgern

M. Soltani, Institut für Mikrointegration (IFM),
Universität Stuttgart

15:10 Kaffeepause

15:40 Neue Technologien

Additive Fertigung mechatronischer Funktionen mittels 3D-MID-Technologien

J. Franke, Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg, FAPS

Aufbau von 3D-Schaltungsträgern auf Basis von dotierten Keramiks substraten

S. Petillon, Institut für Mikrointegration (IFM),
Universität Stuttgart

LPKF LDS Manufacturing Technology - Value adding solution for advanced IC packages

D. Bäcker, LPKF Laser & Electronics AG

17:00 Schlusswort und Ende des Workshops